



FICHE TECHNIQUE

ALLIAGE S-Sn99,3 Cu0,7

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alliage de brasage binaire sans plomb, utilisé dans l'industrie électronique et l'industrie connexe.

- * Alliage eutectique à 0.7 % de cuivre. Point de fusion à 227°C.
- * Très bonne résistance mécanique.
- * Alliage brillant, ne se ternissant pas.
- * Très bonne conductibilité électrique.
- * Absence de plomb.

NORME : Internationale :
Française:

Métal : **ISO 9453** Flux : **ISO 9454.1**
Métal : **NF EN 29453** - C 90550

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Teneur Étain, Sn : Restant
Teneur Cuivre, Cu : 0.45 % à 0.9 %
Intervalle de fusion : 227°C
Masse spécifique : 7.3
Résistance mécanique : Dureté Brinell : 14
Conductibilité électrique : 14 % IACS
Résistivité électrique : 12 μ cm
Température d'utilisation pour fer à souder : 380°- 390° C

ASSURANCE QUALITÉ

Chaque livraison est identifiée par son lot de fabrication muni du certificat de conformité correspondant.

Composition chimique correspondant à celle de stocks disponibles à la date de l'édition et pouvant être sujette à modification. Ces teneurs ne sont qu'indicatives et ne sauraient engager contractuellement TELAMETAL